



# 产 品 承 认 书

产品名称: 1206-T0.8 红外850nm 发射二极管

产品型号: XL-3216HIRC-850

客户名称: \_\_\_\_\_

客户料号: \_\_\_\_\_

承认日期: \_\_\_\_\_

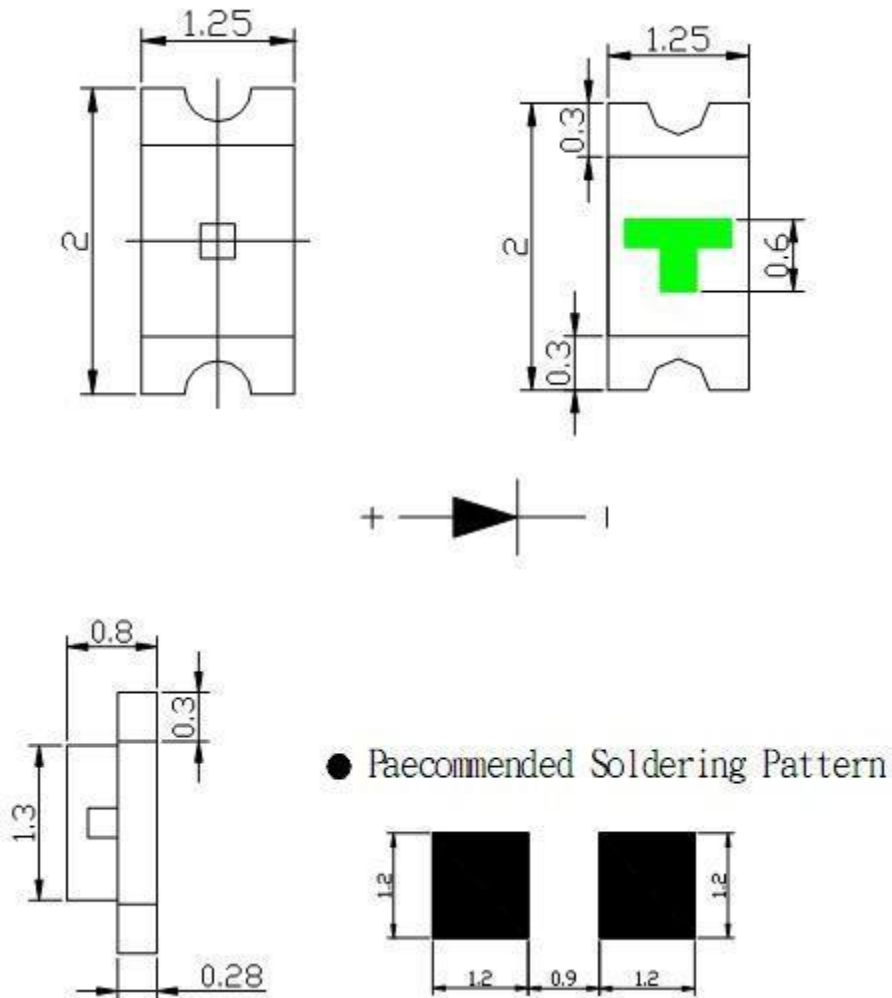
深圳市成兴光电子科技有限公司		
制定	审核	核准

客户承认栏		
确认	审核	核准

### 一、产品描述:

- 外观尺寸(L/W/H) : 3.2 × 1.6 × 0.8 mm
- 颜色: 红外850nm
- 胶体: 透明胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

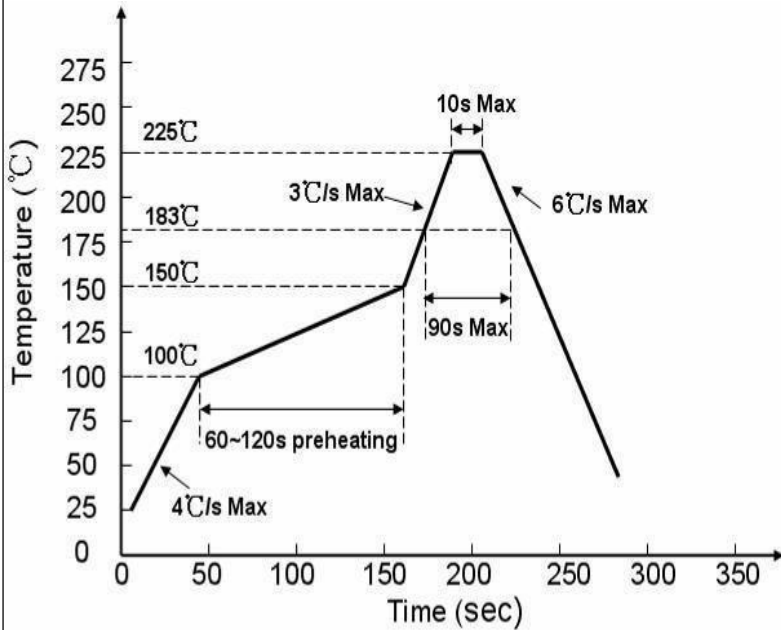
### 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:



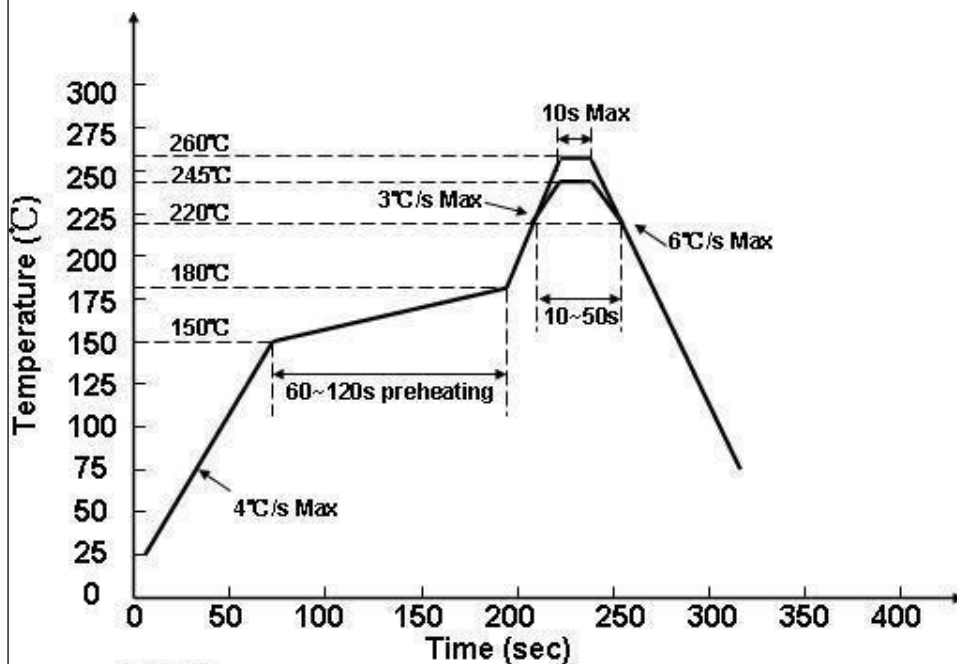
- 备注: 1. 单位 : 毫米 (mm)  
 2. 公差 : 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

## 三、建议焊接温度曲线：

### 3.1、有铅制程



### 3.2、无铅制程



**Notes:**

We recommend the soldering temperature  $245 \pm 5^\circ\text{C}$  ;

The maximum temperature should be limited to  $260^\circ\text{C}$ .



# 产 品 承 认 书

Part No. : **XL-3216HIRC-850**

Version

A.2

Issued date

2019.01.01

Page

3 of 11

## 四、 最大绝对额定值 (Ta=25°C):

参 数	符 号	最大额定值	单 位
消耗功率	Pd	70	mW
最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	I <sub>FP</sub>	70	mA
正向直流工作电流	I <sub>F</sub>	30	mA
反向电压	V <sub>R</sub>	5	V
工作环境温度	T <sub>opr</sub>	-30°C ~ +85°C	
存储环境温度	T <sub>stg</sub>	-40°C ~ +90°C	
焊接条件	T <sub>sol</sub>	回流焊 : 260°C , 5s 手动焊 : 300°C , 3s	

## 五、光电参数 (Ta=25℃):

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	2	----	5	mcd	IF = 20mA
半光强视角	2 $\theta$ 1/2	---	120	---	deg	IF = 20mA
波长	$\lambda_d$	850	---	858	nm	IF=20mA
正向电压	VF	1.2	---	1.6	V	IF=20mA
反向电流	IR	---	---	10	uA	VR=5V

备注: 1. 发光强度是由光纤和过滤器的组合测定的, 因此接近视觉感应曲线;

2. 半光强视角是轴向发光强度一半时的离轴角;

3. 主波长 $\lambda_d$ 源自CIE色度图, 代表单一的波长, 它定义了器件的颜色。



# 产 品 承 认 书

Part No. : XL-3216HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	5 of 11
---------	-----	-------------	------------	------	---------

## 亮度分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
G01	2	3	mcd	IF=20mA
G02	3	4		
G03	4	5		

## 电压分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
H1	1.2	1.3	V	IF=20mA
H2	1.3	1.4		
H3	1.4	1.5		
H4	1.5	1.6		

## 波长分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
HR1	850	852	nm	IF=20mA
HR4	856	858		

### 六、 光电参数代表值特征曲线:

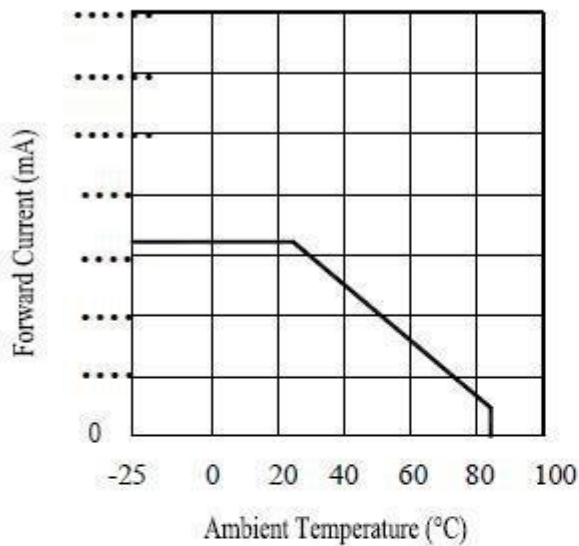


Fig.3 Forward Current vs. Forward Voltage

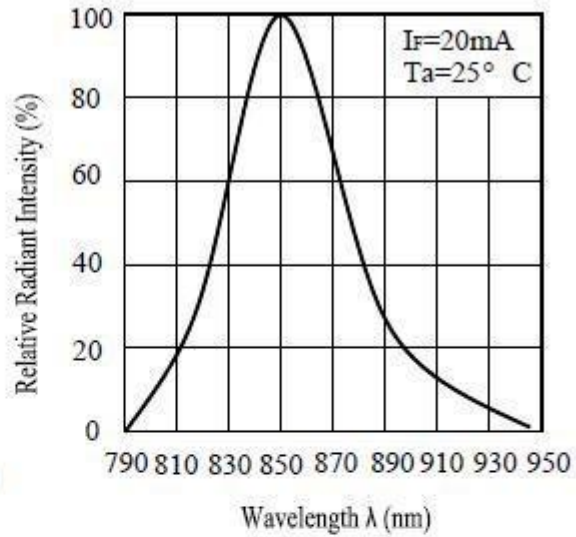
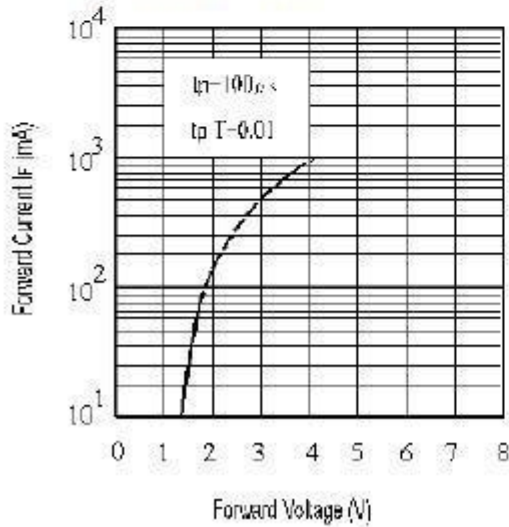
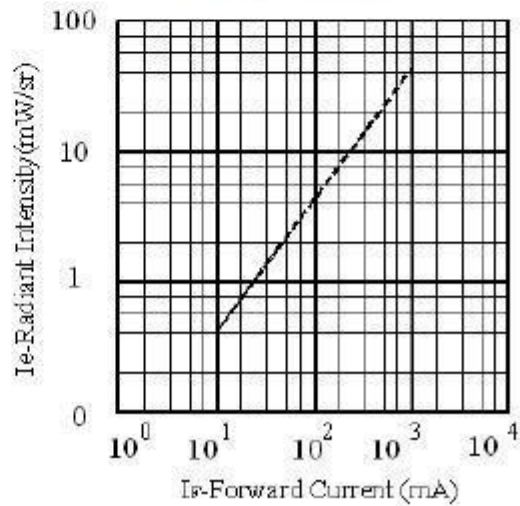


Fig.4 Relative Intensity vs. Forward Current



### 七、标签标识:

CAT: 光强 (mcd)

HUE: 波长 (nm)

REF: 电压 (V)

误差范围

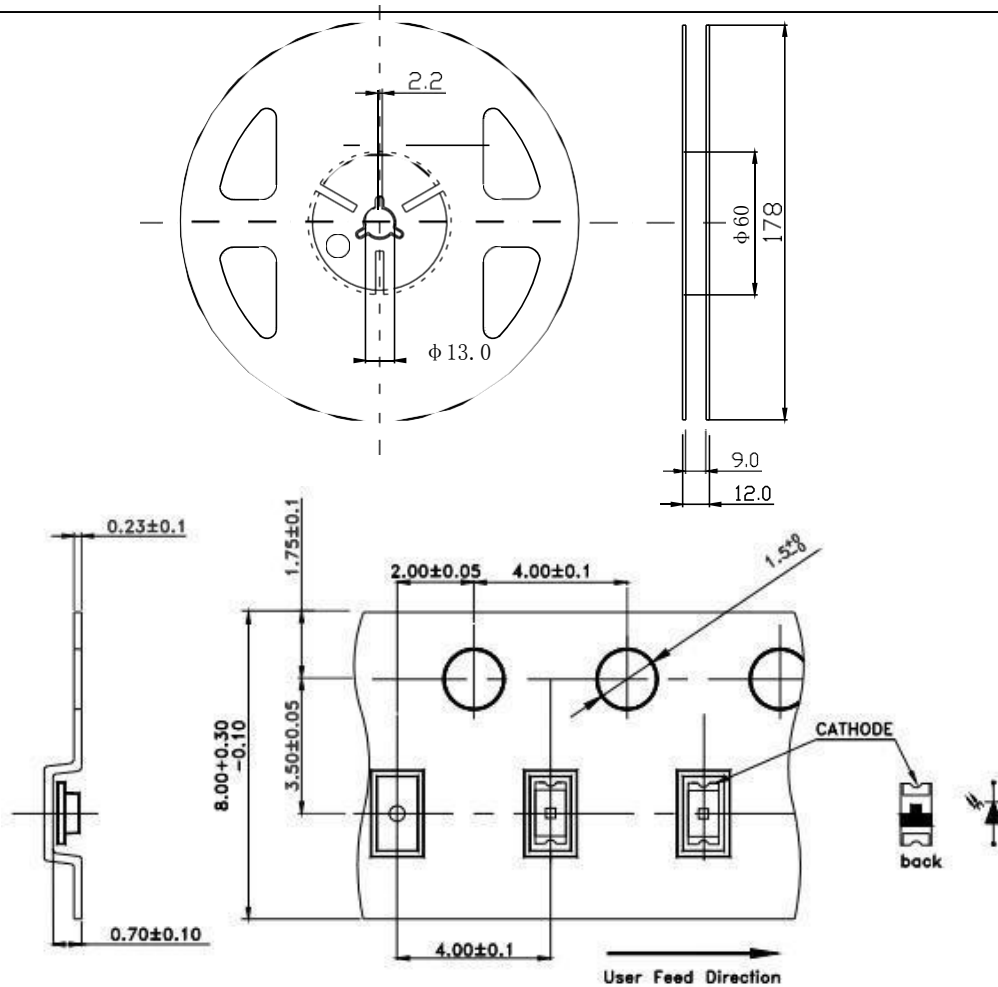
a. Luminous Intensity:  $\pm 15\%$

b. HUE:  $\pm 1\text{nm}$

c. Forward Voltage:  $\pm 0.1\text{V}$



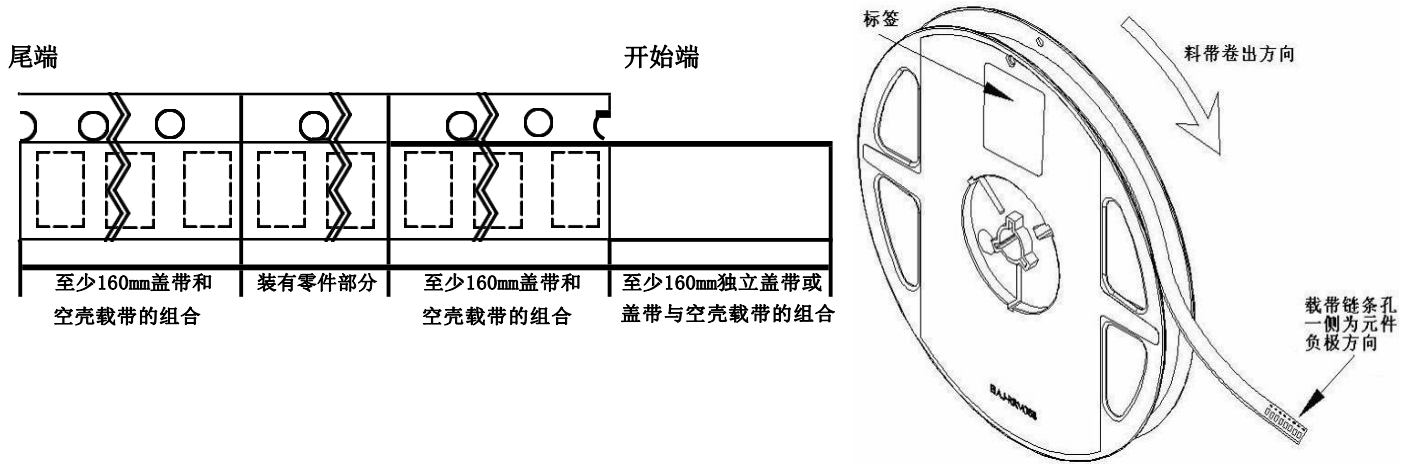
### 八、包装载带与圆盘尺寸:



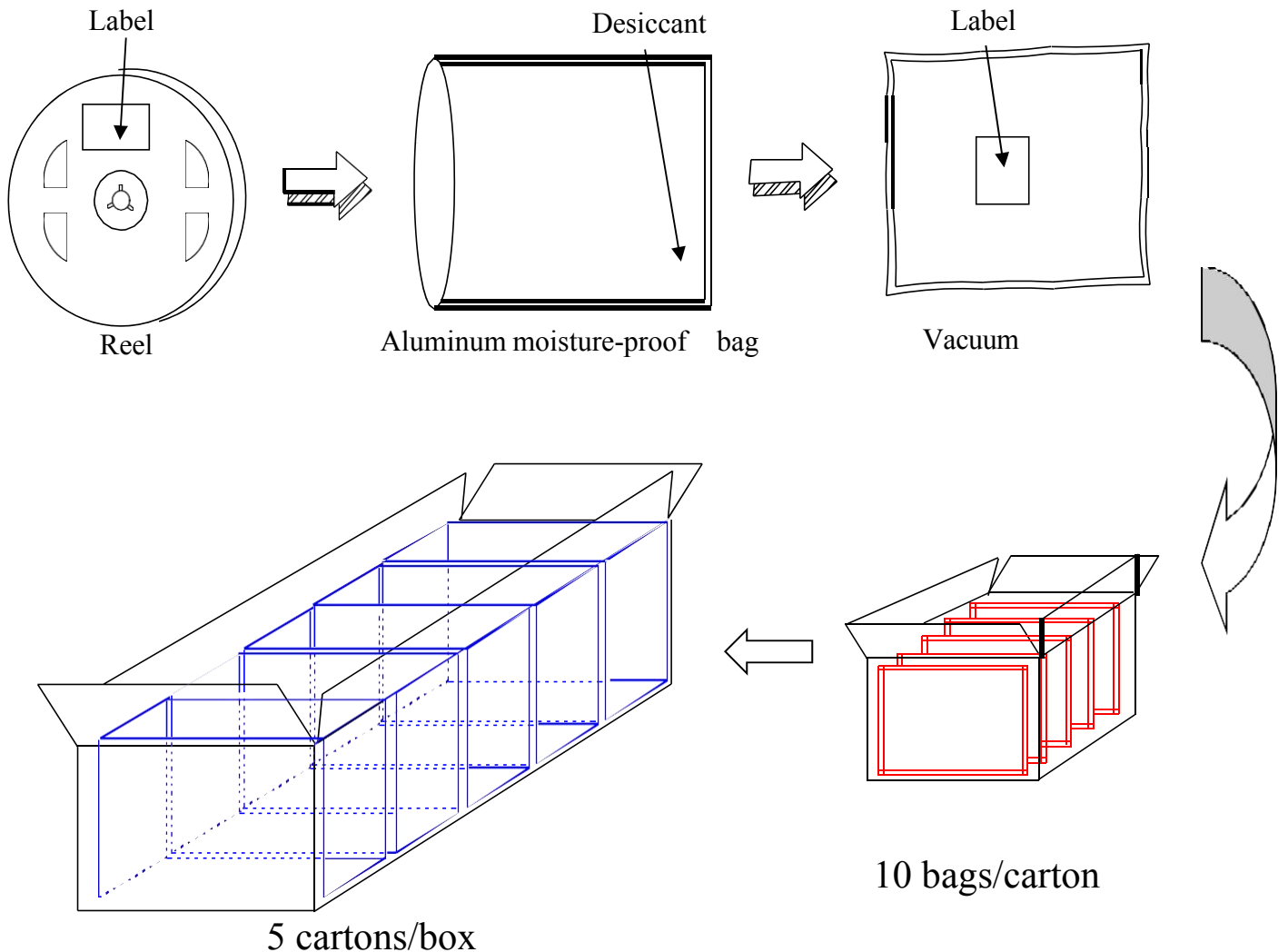
备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm);  
 2. 尺寸公差如无标注, 为 $\pm 0.15\text{mm}$ ;



### 九、圆盘及载带卷出方向及空穴规格:



### 十、内包装及外包装:





# 产 品 承 认 书

Part No. : XL-3216HIRC-850

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	9 of 11
---------	-----	-------------	------------	------	---------

## 十一、信赖性实验：

测试项目	测试条件	测试次数	参考标准	失效判定标准	失效 LED 数量 (PCS)
防潮等级	1. 回流焊最高温度=260℃,10 秒, 2 次回 流焊; 2. 回流焊之前存储条件: 30℃, 相对湿度 =70%, 168H;	-	JEITA ED-4701 300.301	# 1	0/22
焊接信赖性 (无铅回流 焊)	回流焊最高温度=245±5℃, 5 秒 (无铅 回流焊)	-	JEITA ED-4701 303 303A	# 2	0/22
冷热循环	-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟	300 个 循环	JESD22-A104	# 1	0/22
冷热冲击	-35℃ 15分钟 转换时间3分钟 85℃ 15分钟	300 个 循环	JESD22-A106	# 1	0/22
高温存储	Ta=100℃	1000 小时	JESD22-A103	# 1	0/22
低温存储	Ta=-40℃	1000 小时	JESD22-A119	# 1	0/22
常温老化	Ta=25℃ IF=20mA	1000 小时	JESD22-A108	# 1	0/22

### (2) 失效标准

标准 #	项目	测试条件	失效标准
# 1	正向电压(V <sub>F</sub> )	I <sub>F</sub> =20mA	>U.S.L*1.1
	光强 (IV)	I <sub>F</sub> =20mA	<L.S.L*0.7
	反向电流(I <sub>R</sub> )	V <sub>R</sub> =5V	>U.S.L*2.0
# 2	焊接可靠性	/	锡膏覆盖焊盘比例小于 95%

★ U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限

## 十二、使用注意事项：

### ◆ 使用：

1. 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能， 所以为使 LED 有较好的性能表现， 应将 LED 远离热源。

2. 光电参数公差：

正向电压(REF / VF):  $\pm 0.1V$

亮度(CAT / IV):  $\pm 15\%$

波长(HUE / WLD):  $\pm 1nm$

### ◆ 存储：

1. 未打开原始包装的情况下， 建议储存的环境为： 温度  $5^{\circ}C\sim 30^{\circ}C$ ， 湿度 85%RH 以下。当库存超过两个月， 使用前应做除湿处理， 条件  $60^{\circ}C/8$  小时；

2. 打开原始包装后， 建议储存环境为： 温度  $5\sim 30^{\circ}C$ ， 湿度 60% 以下；

3. LED 是湿度敏感元件， 为避免元件吸湿， 建议打开包装后， 将其储存在有干燥剂的密闭容器内， 或者储存在氮气防潮柜内；

4. 打开包装后， 元件应该在 168 小时（7 天）内使用； 且贴片后应尽快完成焊接；

5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天）， 应做除湿处理；

烘烤条件：  $60^{\circ}C/24$  小时。

### ◆ ESD 静电防护

LED（特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED）是静电敏感元件， 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常， 比如漏电流过大， VF 变低， 或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套；

2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等， 应该做适当的接地保护（接地阻抗值  $10\Omega$  以内）；

3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱， 严禁使用普通塑料制品；

4. 建议在作业过程中， 使用离子风扇来抑制静电的产生；

5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。



# 产 品 承 认 书

Part No. : **XL-3216HIRC-850**

Version	A.2	Issued date	2019.01.01	Page	11 of 11
---------	-----	-------------	------------	------	----------

## ◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

## ◆ 焊接

- 1 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
- 2 回流焊焊接次数不得超过两次；
- 3 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。  
烙铁最大功率应不超过 30W；
- 4 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；
- 5 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

## ◆ 其他

- 1 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 2 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
- 3 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。